

贝格斯Gap Pad导热填缝材料

产品名称	贝格斯Gap Pad导热填缝材料
公司名称	南京瑞森包装有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:贝格斯 材质:有机硅橡胶
公司地址	中国 江苏 南京市白下区 大光路47号宏鹰大厦708室
联系电话	86 025 84587509 13357811313

产品详情

品牌	贝格斯	型号	Gap Pad 1500R , Gap PadA2000
材质	有机硅橡胶		

gap pad导热填缝材料 贝格斯gap-pad间隙材料是由低模量聚合物附在玻璃纤维基材上制成，应用于半导体器件如qfp、bga的顶部(通常情况下，几个不同高度的器件共享一个散热片)、pcb和母板、框架或导热板之间。gap pad具有高度的形状适应性，并有不同的导热系数和厚度可供选择。gap-pad为高低不平的表面、气隙和粗糙的表面提供有效的传热界面，它具有以下特点：1. 低模量聚合物5. 电气绝缘 2. 玻纤增强或非增强 6. 单面或双面自然黏性(带保护膜) 3. 特殊填料以得到特殊性能 7. 不同的厚度和硬度 4. 高度的表面适应性 8. 不同的导热系数 以下是一些选择和性能：1. 高形状适应性、导热绝缘、有填充作用。 2. 有各种膜量强度[gap pad vo](#),[gap pad vo soft](#),[gap pad vo ultra soft](#)等。 3. 厚度由0.5mm到5.0mm不等。 4. 应用于外壳散热的设备，如硬盘、光驱等，能垫平高低不平的发热元件。 5. 有更高导热系数的[gp1500](#),[gp a2000](#),[gp a3000](#)供选择。